Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz

Ihr Ansprechpartner
Jens Jungmann

Durchwahl
Telefon +49 351 564 80600
Telefax +49 351 564 80680

presse@smwa.sachsen.de*

13.06.2023

Bund und Land fördern Technologieprojekte im »Silicon Saxony« mit voraussichtlich rund 877 Millionen Euro

Kabinett leitet Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung für IPCEI-Vorhaben ein | Martin Dulig: »Scheuen den Wettbewerb mit Asien nicht«

Die Entwicklung der Chiptechnologie in und um Dresden erhält den nächsten Innovations-Schub. Im Rahmen eines »wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischem Interesse« (IPCEI) sollen auch neun sächsische Projekte für technologischen Vorsprung der europäischen Mikroelektronik- und Kommunikationstechnikindustrie sorgen. Brüssel hat dafür am 8. Juni das finale »Go« gegeben. Der Freistaat schafft nun die Voraussetzungen für die Länderbeteiligung an der Förderung. Das Kabinett hat das sächsische Wirtschaftsministerium (SMWA) heute beauftragt, die mit dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) ausgearbeitete Verwaltungsvereinbarung abzuschließen.

Damit sollen die beteiligten Unternehmen schnell Klarheit über die Fördersummen erhalten. Das Gesamtvolumen aller sächsischen Projekte beträgt derzeit bis zu 2,24 Milliarden Euro. Bund und Freistaat werden sie mit voraussichtlich rund 877 Millionen Euro fördern, wovon 70 Prozent durch den Bund und 30 Prozent durch das Land – vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Sächsischen Landtages – bereitgestellt werden. Die Summen können sich im Rahmen der laufenden nationalen Antragsprüfung bis zur Ausreichung der Förderbescheide an die Unternehmen noch ändern.

Dazu sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig: »Die Unternehmen im Silicon Saxony haben bewiesen, dass sie noch viele Ideen für energieeffiziente Chips, modernste Sensoren und neue Materialien haben. Deshalb scheuen wir den Wettbewerb mit Asien nicht. Aber unsere Prozesse müssen schneller werden. Deshalb macht der Freistaat Tempo, damit die zukunftsweisenden Projekte aus Sachsen richtig Fahrt aufnehmen können.

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

www.smwa.sachsen.de

Zu erreichen ab Bahnhof Dresden-Neustadt mit den Straßenbahnlinien 3 und 9, ab Dresden-Hauptbahnhof mit den Linien 3, 7 und 8. Haltestelle Carolaplatz.

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Gerade in der Mikroelektronik ist Innovation der Schlüssel für den Erfolg von morgen.«

Projekte folgender Unternehmen sollen von Bund und Land gefördert werden: **Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG**, **GlobalFoundries Dresden Module One LLC & Co. KG**, **Robert Bosch GmbH** (Dresden), **Robert Bosch SMD GmbH** (Dresden), **Bosch Sensortec GmbH** (Dresden), **Ferroelectric Memory GmbH** (Dresden), **Freiberger Compound Materials GmbH** (Freiberg), **NXP Semiconductors Germany GmbH** (Dresden) und **Siltectra GmbH** (Dresden). Die zu fördernden Vorhaben reichen von der Erforschung und Entwicklung neuartiger Speichertechnologien über neue Basismaterialien für Hochleistungs-Prozessoren bis zur weiteren Automatisierung der Industrieprozesse.

Übrigens, kennen Sie schon unseren #ZUKUNFTblog?

Auf www.smwa.sachsen.de/blog finden Sie spannende Themen, Fotos und Videos zu vielen Themen des SMWA, welche Sie wie eine PM für Ihre Arbeit nutzen können. Sie haben dort Zugriff u.a. auf die neueste Ausgabe unseres Informationsformates »Martin Dulig | Konkret«, »Deine Arbeit, meine Arbeit«, unsere Podcasts bei Spotify, Google und Apple sowie auf unseren Youtube-Kanal.

Links:

PM BMWK vom 08.06.23: Habeck: „Wichtiger industriepolitischer Meilenstein: EU-Kommission genehmigt 31 Mikroelektronik Projekte aus 11 Bundesländern. Mikroelektronik-Standort Deutschland wird in der Breite gestärkt."

PM SK vom 08.06.23: Ministerpräsident Kretschmer begrüßt Abschluss der Beihilfeprüfung des IPCEI durch EU